

XENSIV™ IM73D122V01 非常に低い自己雑音のデジタルMEMSマイク

きわめて低い自己雑音を誇るデジタルXENSIV™ MEMSマイクIM73D122は、非常に高いSN比(低自己雑音)と感度が求められるアプリケーション向けに設計されています。フラットな周波数特性(20 Hzの低周波ロールオフ)と少ない製造公差により、マルチマイクロホン(アレイ)アプリケーションの性能を向上させます。本マイクは、インフィニオンの新しいシールドデュアルメンブレンMEMS技術を使用しており、マイクロフォンレベルで高い耐環境性(IP57)を実現しています。

非常に高いSN比と高い感度の強力な組み合わせにより、ノートパソコン、タブレット端末、会議用機器などの音声ユーザーインターフェースアプリケーションにおいて、高品質な音声キャプチャを可能にします。



主な特長

- > 非常に低い自己雑音/非常に高いSN比 73 dB(A)
- > 超高感度 (-26 dBFS)
- > SDM (Sealed Dual Membrane) 技術により、マイクレベルではIP57の防塵性能を実現
- > 広ダイナミックレンジと高い最大入力音圧レベル (AOP) 122 dB SPLを実現
- > 非常に少ない製品間の位相と感度バラツキ (± 1 dB)
- > フラットな周波数特性で、LFRO (低域ロールオフ) は20Hzと非常に低い
- > 非常に低い群遅延 (7 μ s@1 kHz)

主な利点

- > パワフルな遠距離音声と小音量音声をピックアップ
- > マイクロフォンレベルの高い耐環境性 (IP57)
- > 高度なオーディオ機能 (オーディオズーム、ビームフォーミング)

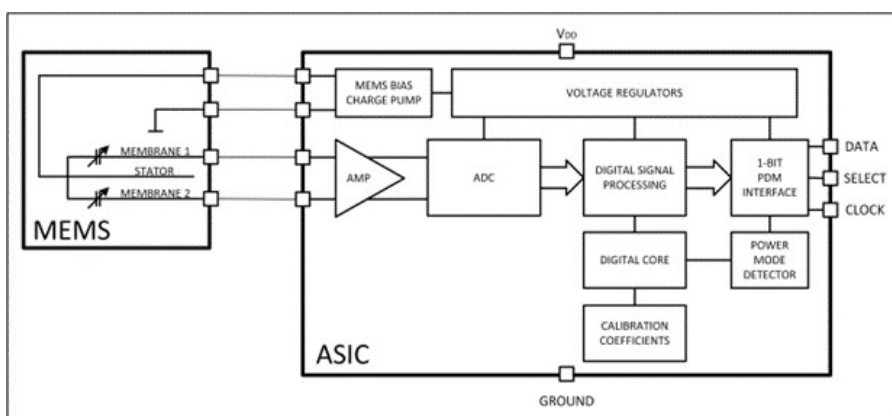
競合製品に対する優位性

- > 高度な機能 (上記参照)
- > インフィニオンの総合サポート (技術資料、ディスカッションフォーラムコミュニティ、第1レベルおよび第2レベルのサポート)

対象アプリケーション

- > ラップトップPC、タブレット
- > 会議システム
- > スマートスピーカー
- > カメラ

ブロック図



製品関連情報/オンラインサポート

[製品ページ](#)

製品概要およびユーザーマニュアルへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
IM73D122V01XTMA1	SP005675385	PG-LLGA-5
KITIM73D122V01FLEXTOBO1	SP005728208	

FAQ 【XENSIV™ IM73D122V01非常に低い自己雑音のデジタルMEMSマイク】

FAQ	
1. Why is Infineon launching own microphone modules?	
	As a market bare die leader for MEMS microphone Infineon wants to control the quality and push innovations among all main microphone components – MEMS, ASIC and package.
2. What is next in XENSIV™ MEMS microphone roadmap?	
	Currently portfolio includes multiple high-performance low size and low power consumption microphones with even more even more in qualification pipeline
3. Why does high end microphone matter?	
	Especially for the application which require high quality audio pick up (laptops, conference systems, cameras, etc.) wide dynamic range microphones significantly outperform peers with lower SNR and AOP